

株式会社東京精密 2018年度(平成31年3月期)第2四半期 決算説明会  
質疑応答 要約

2018年11月13日 開催

- 本資料は、2018年11月13日に開催された2018年度第2四半期決算説明会の質疑応答の内容を、当社の判断で要約したものです。
  - 本資料に記載されている情報は、決算説明会開催日時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
  - なお、本資料では、半導体製造装置事業セグメントを「SPE」、第1四半期(4-6月期)を1Q、第2四半期(7-9月期)を2Qと表現します。
1. 2018年8月にSPE業績予想を下方修正した一方で、2Qに増収、かつ上方修正に至った経緯を聞きたい。
    - まず部材供給の状況だが、逼迫してはいるものの、順次納入されている。
    - プローバによるデバイス測定は、温度を変化させて行う事が多いが、近年、低温測定のニーズが増加している。当社は低温測定用にチラー(冷却装置)を提供しているが、この生産が特に6月頃逼迫し、8月時点でも改善を見込みづらかったことが1Qの減収、かつ下方修正の要因の一つであった。
    - 様々な施策を実施した結果、9月時点でチラーの生産能力が倍増し、特に9月の売上高増加に貢献した結果、増収増益となった。
    - またメモリデバイス向け以外の需要は好調を維持しており、特にTDDI(Touch and Display Driver Integration)等のディスプレイドライバICの測定時間増加による検査需要の増加、イメージセンサ(以下CIS)、マイクロLEDなどの需要見通しを加味し、今回の予想修正に至っている。
  2. 前述の低温測定が増加している背景と、検査需要増減の関係について聞きたい。
    - 車載やメモリデバイスなどで高信頼性を担保する測定需要が増加している事に加え、一部の画像処理デバイスでは、検査時の吸熱要求が増加している。
    - この結果、近年はプローバの総受注台数の半分が低温測定オプションを必要とし、台数では100-120台/月に及ぶケースもある。
    - ただし、これ自体は測定速度に影響を与えない。高温測定・低温測定 両方を行う事になる結果としてテスト工程が増加し、プローバ需要が増加する。
    - なお、前述のチラーは低温測定の付帯設備となるため、当社が統計用に提供するプロ

ーバの売上高には、この価額が含まれている。

3. 2Q の SPE 受注が想定を上振れた要因は?
  - メモリ以外のデバイス向け需要が想定以上に堅調だったことによる。
4. 2Q の SPE 受注のデバイス別構成について、1Q と変化はあるか。
  - 2Q にかけて、CIS やディスプレイドライバ IC 向けの受注が目立ってきた。
  - プローバの 2Q 受注 デバイス別構成比を見ると、メモリ向け 4 割、ロジック系(ディスプレイドライバ IC 含む) 4 割、センサ・電子部品が 1 割弱の水準で、メモリ比率は 1Q 対比で若干減少している。メモリ向けを分解すると、1Q はやや NAND フラッシュメモリ向けが多く、2Q は逆に DRAM の比率が高い。
5. 2018 年度下期(2018 年 10 月-2019 年 3 月) の SPE 受注見通しが、上期(4-9 月)対比で減少すると見込む理由は?
  - メモリ向け需要の減速を想定している。その他のデバイス向け需要の考え方は、市場の認識とそう変わらない。ただ、顧客毎に投資意欲の濃淡がある。
6. 下期の SPE 売上計画が、上期末の SPE 受注残高と比較して少ない理由は?
  - 特にプローバの長納期化が理由。納期はチラーの有無によらず、半年程度となっている。顧客要望を踏まえ、新工場等により短縮化を図ろうとしている。
7. SPE 受注残高の増加を踏まえ、計画生産などの短納期化対応は実施しているか?
  - 生産能力が逼迫し、フォーキャストに基づいた生産を優先しているため、計画生産が実施できる環境にはない。
8. 8 月の業績予想修正時、「製品・仕掛在庫の想定以上の増加に伴う会計影響」が 10 億円程度あるとの事だったが、この影響は計画に織り込んでいるのか?
  - 本年末の製品在庫は上期末と同水準を想定しており、下期の改善効果は想定していない。翌年度以降になると考える。
9. 通期利益計画を、下期を見ると 8 月時点より数億引き下げている理由は?
  - 下期の研究開発費の増加(上期比 +5 億)、設備投資計画が具体化したことによる不動産関連コスト 5~6 億、並びに人件費の増加を新たに織り込んだため。
10. 通期計画において、メモリ向け需要減少、並びに米中貿易摩擦リスクをどの程度織り込んでいるのか?
  - 一部のメモリメーカーの投資凍結に加え、この 1 週間でも新たに追従するメーカーの動き

を聞いていることから、メモリ向けは減少リスクを相当織り込んでいる、

- 米中貿易摩擦リスクは一企業として定量判断しづらいが、中国需要という見方では、メモリ向け需要の減速に加え、政府補助金が出なくなるケース、為替要因で予算が足りなくなるケース、半導体メーカ乱立のリスクなどを一定程度織り込んでいる。

11. SPE 市場に不透明感がある中、従業員の増強を続けるのか?

- 続けてゆく所存。

12. 2018 年 5 月開催の決算説明会で、メモリ向けプローバの出遅れを示唆、その後受注面でキャッチアップが進んでいる旨を示したが、現況と、今後の利益面での影響は?

- 受注面ではキャッチアップしていると認識。ただ製品納期の関係から、売上面でのキャッチアップには時間を要する。製造原価は相対的にやや高い状況にはある。

13. ウェーハ製造装置の需要動向はどうか。

- 納期はいまだ 1 年程度超の状態が継続しているが、当該装置の需要は、間欠泉(低水準で推移し、一定時期に増加、再び減少する)のような傾向を示す。現在は良い状況と認識している。

14. 中長期の SPE 需要見通し、成長期待分野などに関するコメントをお願いしたい。

- 半導体デバイス需要は無くならない。またデータ量も増加の一途をたどっており、いずれメモリ向け需要も回復する。総じて、現在は「先の見えたりセッション」と捉えている。また季節性(冬場に軟調な受注動向を示し、春先に回復する)も続いているので、春先には需要の回復を想定している。

15. 計測事業で新棟を建設する旨、示しているが、この目的と期待される効果は。

- 三次元座標測定機の受注・売上が好調で、工場のキャパシティが一杯の状態であり、この生産能力を拡大させることが目的。新棟完工後は、現在の生産能力を 5 割程度拡大できると見込んでいる。

16. 光計測製品の販売拡大に関する進捗は?

- 売上構成比はそれほど増加していないが、引合は確実に増加している。最近開催された JIMTOF(日本国際工作機械見本市)にも出展し、十分な手ごたえを感じた。結実するのは近いと考えている。

以上